

В полупроводниковых структурах, p — n -переходы которых включены в обратном направлении, тепловой пробой возникает вслед за лавинным или туннельным пробоем при прохождении токов большой плотности и ведет к разрушению прибора при недостаточно интенсивном отводе тепла. Если учесть, что при лавинном пробое p — n -перехода величина тепловыделения P может достигать 10^{10} Вт/см³ [1], то тепловой баланс при флуктуации температуры 100 К может быть обеспечен носителями с концентрацией 10^{19} . . 10^{20} см⁻³ и временами релаксации 10^{-10} . . 10^{-12} с.

Список литературы

- [1] Субашиев А. В., Фишман И. М. // ЖЭТФ. 1987. Т. 93. В. 12. С. 2264—2266.
- [2] Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. М., 1979. 280 с.
- [3] Кочелап В. А., Мельников Л. Ю., Соколов В. Н. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 7. С. 1324—1326.
- [4] Вондаренко П. Н., Емельянов О. А., Койков С. А. // Письма ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 16. С. 45—48.
- [5] Калафати Ю. Д., Неменуций В. Н., Ржанов Ю. А. // ЖТФ. 1989. Т. 59. В. 9. С. 15—20.

Черновицкий
государственный университет

Получено 21.12.1990
Принято к печати 2.04.1991

ФТП, том 25, вып. 8, 1991

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОПРОВОДИМОСТИ В a -Si : H p -ТИПА

Казанский А. Г., Кузнецов С. В.

Фотопроводимость в пленках a -Si : H p -типа исследована существенно в меньшей степени по сравнению с фотопроводимостью в нелегированных пленках и пленках n -типа. В частности, недостаточно изучены температурные зависимости фотопроводимости [1, 2]. В то же время исследование температурных зависимостей $\Delta\sigma$ позволяет определить механизмы рекомбинации неравновесных носителей в a -Si : H и понять влияние на величину фотопроводимости таких характеристик образца, как концентрация дефектов и примесей в нем. Поэтому в настоящей работе были проведены исследования температурных зависимостей фотопроводимости в a -Si : H p -типа с различным уровнем легирования.

Исследовались пленки a -Si : H толщиной ~ 1 мкм, полученные разложением в ВЧ глеющем разряде смеси газов моносилана (SiH_4) и диборана (B_2H_6) при температуре подложки 250 °С. Относительное объемное содержание газов в смеси составляло $k = [\text{B}_2\text{H}_6]/[\text{SiH}_4] = 3 \cdot 10^{-7} - 10^{-3}$. Измерения проводились в области температур 110—450 К при возбуждении образцов излучением с энергией кванта 1.9 эВ интенсивностью $I \approx 10^{14}$ см⁻²·с⁻¹. Перед измерениями образцы отжигались в вакууме 10^{-3} Па в течение 30 мин при температуре 180 °С.

На рис. 1 для некоторых образцов a -Si : H, легированных бором, представлены температурные зависимости фотопроводимости $\Delta\sigma = \sigma_\phi - \sigma_t$, где σ_t и σ_ϕ — соответственно проводимость образца в темноте и при освещении его светом. На этом же рисунке для сравнения показана температурная зависимость $\Delta\sigma$ для нелегированного a -Si : H. Зависимости $\Delta\sigma$ получены в процессе понижения температуры. Как видно из рисунка, для нелегированного a -Si : H в области температур 170—210 К наблюдается температурное гашение $\Delta\sigma$. Анализ зависимости $\Delta\sigma(T)$ слабо легированного a -Si : H был проведен в работе [3]. Как было показано в [3], в слабо легированном a -Si : H фотопроводимость определяется электронами в области низких температур и дырками в области

высоких температур. Смена типа проводимости происходит при температуре, при которой наблюдается переход от слабой зависимости $\Delta\sigma(T)$ к экспоненциальному возрастанию $\Delta\sigma$ с ростом температуры. Как видно из рис. 1, для образцов с $k < 3 \cdot 10^{-6}$ увеличение степени легирования бором приводит к существенному уменьшению величины $\Delta\sigma$ в «электронной области» зависимости $\Delta\sigma(T)$ и некоторому возрастанию $\Delta\sigma$ в «дырочной области». При этом температура перехода от n -типа к p -типу фотопроводимости смещается в область низких температур. Для $k > 3 \cdot 10^{-6}$ фотопроводимость определяется дырками во всей исследованной температурной области.

Рассмотрим область температур, в которой $\Delta\sigma$ определяется переносом дырок. Увеличение $\Delta\sigma$ с ростом температуры, по нашему мнению, связано с выбросом дырок в валентную зону с состояний хвоста валентной зоны. Если данные состояния не участвуют в рекомбинационных переходах, то время жизни дырок определяется концентрацией нейтральных оборванных связей (N^0) (по-

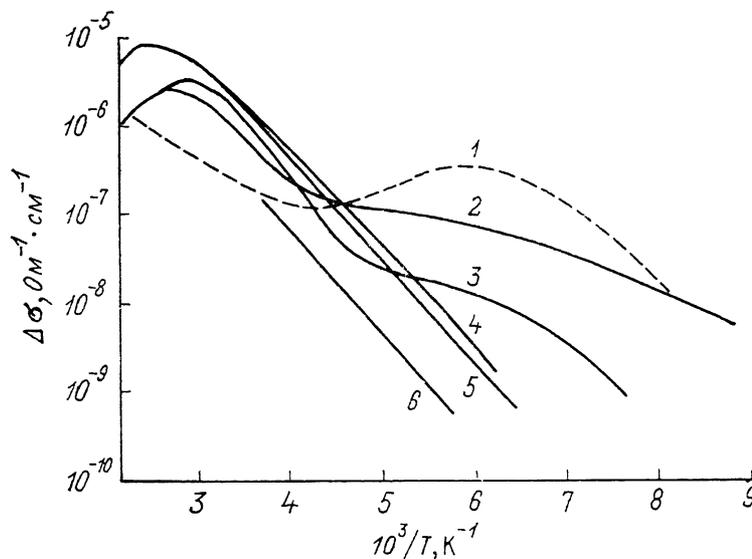


Рис. 1. Температурные зависимости фотопроводимости нелегированного $a\text{-Si}:\text{H}$ (1) и $a\text{-Si}:\text{H}$, легированного бором (2—6).

k : 2 — $3 \cdot 10^{-7}$, 3 — 10^{-6} , 4 — $3 \cdot 10^{-6}$, 5 — 10^{-4} , 6 — 10^{-3} .

скольку в $a\text{-Si}:\text{H}$ p -типа N^0 существенно превосходит концентрацию отрицательно заряженных оборванных связей [4]). С использованием уравнения нейтральности в рассматриваемой области температур было показано, что $N^0 \approx p_i + N_0^0$, где N_0^0 — концентрация N^0 в темноте, а p_i — концентрация дырок, захваченных на состояниях хвоста валентной зоны. Поэтому в области низких температур, при которых выполняется соотношение $p_i > N_0^0$, уменьшение p_i с ростом температуры приводит к уменьшению N^0 и соответственно увеличению $\Delta\sigma$.

В области высоких температур концентрация центров рекомбинации определяется равновесным значением N_0^0 . Поскольку в образцах p -типа уровень Ферми (E_f) расположен ниже энергетического положения состояний нейтральной оборванной связи [5], в соответствии с выражением для вероятности нахождения оборванной связи с положительной энергией корреляции в нейтральном состоянии [6] рост температуры приводит к увеличению N_0^0 . Помимо этого, согласно модели равновесных дефектов [7], в области высоких температур возможно увеличение с температурой полной концентрации дефектов (N). Это вызывает уменьшение $\Delta\sigma$ с ростом температуры.

Заметим, что наблюдаемый характер изменения $\Delta\sigma$ в дырочной области фотопроводимости можно также интерпретировать в рамках модели Роуза [8], согласно которой увеличение температуры должно приводить к смещению

демаркационных уровней дырок и электронов к середине щели подвижности и соответственно к уменьшению центров рекомбинации расположенных между ними. В соответствии с работой [9] более оправдано рассмотрение состояний, расположенных между квазиуровнями Ферми для захваченных носителей. Оценка положения квазиуровня Ферми для свободных дырок (E_f^p) относительно края валентной зоны (E_v), проведенная для образца с $k=10^{-4}$, показывает, что при увеличении температуры от 170 до 400 К (температуре, соответствующей максимуму $\Delta\sigma$) величина $E_f^p - E_v$ увеличивается от 0.36 до 0.52 эВ. Значение $E_f^p - E_v$ оценивалось из соотношения $E_f^p - E_v = kT \ln(\sigma_m/\sigma_\phi)$, где предполагалось, что минимальная металлическая проводимость для дырок совпадает с соответствующей величиной для электронов [10] и равна $\sigma_m = 150 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ [11]. Поскольку плотность состояний в хвосте валентной зоны превосходит плотность состояний оборванных связей, расположенных в середине щели подвижности, в области низких температур уменьшение рекомбинационных центров с ростом температуры определяется смещением E_f^p к середине щели подвижно-

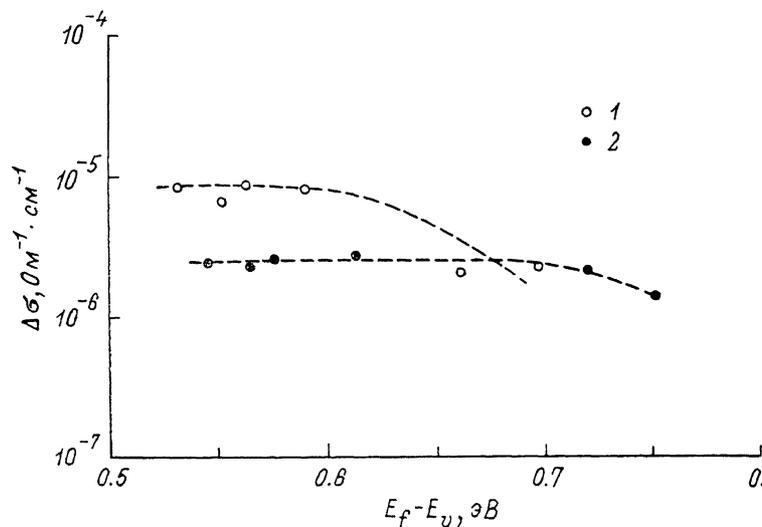


Рис. 2. Зависимости фотопроводимости от положения уровня Ферми. Т, К: 1 — 300, 2 — 400.

сти по состояниям хвоста. Наконец, в области высоких температур главную роль в рекомбинации дырок играют нейтральные оборванные связи.

Как в случае первой, так и в случае второй интерпретации в области увеличения $\Delta\sigma$ с ростом температуры скорость рекомбинации определяется плотностью состояний в хвосте валентной зоны. Причем показатель люкс-амперной зависимости γ ($\Delta\sigma \sim I^\gamma$) должен быть меньше 1. Проведенные нами измерения показали, что в данной области температур $\gamma \approx 0.5 - 0.6$. В области высоких температур рекомбинация и соответственно величина $\Delta\sigma$ определяются концентрацией N_0^o .

Из спектров коэффициента поглощения в дефектной области, полученных методом постоянного фототока [12], мы оценили концентрацию дефектов при комнатной температуре в исследованных образцах. При увеличении легирования от $k=3 \cdot 10^{-7}$ до $k=10^{-4}$ величина N возрастает в ~ 40 раз по закону, близкому к $\exp\left[-\frac{E_f - E_v}{\Delta E}\right]$, где $\Delta E \approx 0.14$ эВ, а $E_f - E_v$ определялось аналогично $E_f^p - E_v$, но с использованием значения темновой проводимости при комнатной температуре. В то же время, как видно из рис. 1, $\Delta\sigma$ в дырочной области фотопроводимости изменяется существенно слабее.

Рассмотренная выше интерпретация процессов рекомбинации позволяет понять зависимость $\Delta\sigma$ от уровня легирования в образцах *p*-типа. На рис. 2 показаны зависимости $\Delta\sigma$ от положения E_f (которое мы использовали в каче-

стве параметра, характеризующего уровень легирования) для двух температур, соответствующих областям увеличения и уменьшения $\Delta\sigma$ с ростом температуры. Слабая зависимость $\Delta\sigma$ при $T = 300$ К от легирования и соответственно от концентрации дефектов связана с тем, что, как было показано выше, в области комнатных температур величина $\Delta\sigma$ определяется плотностью состояний в хвосте валентной зоны. Это, в частности, может объяснить уменьшение $\Delta\sigma$ в образце с максимальным уровнем легирования $k = 10^{-3}$ (рис. 1). Действительно, согласно [13], в сильно легированных бором образцах α -Si : H возрастает структурная неоднородность, что может привести к увеличению плотности состояний в хвосте валентной зоны. В то же время представленное на рис. 2 изменение $\Delta\sigma$ с легированием при $T = 400$ К связано с изменением при легировании концентрации нейтральных оборванных связей, которое определяется двумя факторами: увеличением полной концентрации дефектов при легировании и уменьшением относительной концентрации N_0^0 вследствие смещения положения E_j к валентной зоне [4].

Авторы выражают искреннюю признательность В. Фусу и Х. Меллу за предоставление образцов для исследований.

Список литературы

- [1] Vanier P. E., Delahoy A. E., Griffith R. W. // J. Appl. Phys. 1981. V. 52. N 8. P. 5235—5242.
- [2] Hoheisel M., Fuhs W. // Phil. Mag. B. 1988. V. 57, N 3. P. 411—419.
- [3] Казанский А. Г., Климашин И. В., Кузнецов С. В. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 9. С. 1628—1631.
- [4] LeComber P. G., Spear W. E. // Phil. Mag. B. 1986. V. 53. N 1. P. L1—L7.
- [5] Jousse D. // Appl. Phys. Lett. 1986. V. 49. N 21. P. 1438—1440.
- [6] Stutzman M., Jackson W. B. // Sol. St. Commun. 1987. V. 62. N 3. P. 153—158.
- [7] Street R. A., Winer K. // Phys. Rev. B. 1989. V. 40. N 9. P. 6236—6249.
- [8] Поуз А. Основы теории фотопроводимости, М., 1966. 192 с.
- [9] Simmons J. G., Taylor G. W. // Phys. Rev. B. 1971. V. 4. N 2. P. 502—511.
- [10] Kakalios J., Street R. A. // Phys. Rev. B. 1986. V. 34. N 8. P. 6014—6017.
- [11] Overhof H., Thomas P. // Electronic Transport in Hydrogenated Amorphous Semiconductors (V. 114) of Springer Tracts in Modern Physics / Ed. by G. Hohler, E. A. Niekish. 1989.
- [12] Вавилов В. С., Казанский А. Г., Миличевич Е. П. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 11. С. 2051—2053.
- [13] Beyer W., Wagner H., Mell H. // Sol. St. Commun. 1981. V. 39. N 2. P. 375—379.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Получено 12.03.1991
Принято к печати 4.04.1991

ФТП, том 25, вып. 8, 1991

ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В КРЕМНИИ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ УГЛЕРОДА

Мудрый А. В., Патук А. И., Шакин И. А.

Образование первичных дефектов и комплексов с их участием в кремнии, облученном электронами при температурах < 200 К, было зарегистрировано с помощью методов электронного парамагнитного резонанса, инфракрасного поглощения и нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней [1–5]. Установлено, что при низкотемпературном облучении в кристаллах образуются вакансии, дивакансии, междоузельные примесные атомы алюминия, бора, галлия, комплексы с собственными междоузельными атомами кремния, углеродом и кислородом [1–5]. В [6, 7] исследовалась люминесценция кремния после низкотемпературного (~ 100 К) облучения электронами. Основным результатом этих работ явилось то, что образование оптически активных дефектов зарегист-